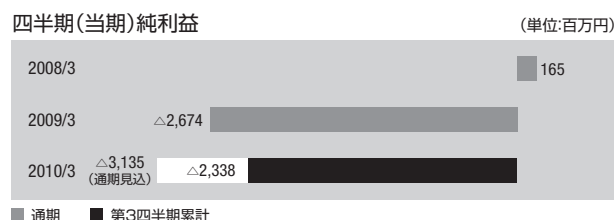
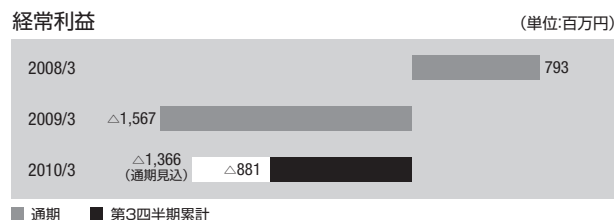
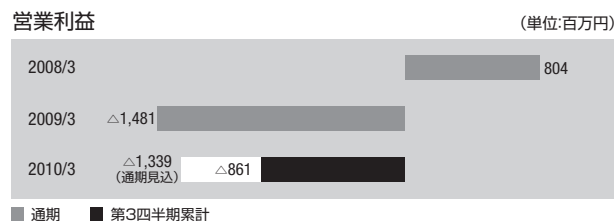
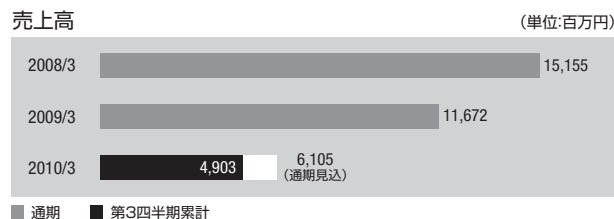
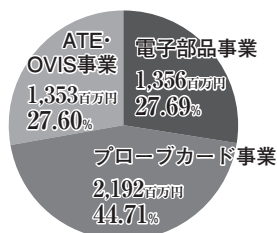


業績ハイライト



部門別売上高構成比



株主メモ

事業年度 4月1日～翌年3月31日
 定時株主総会 毎年6月
 上記基準日 毎年3月31日
 その他必要あるときは、あらかじめ公告して臨時に基準日を定めます。

配当金受領株主確定日 期末配当金 — 3月31日
 中間配当金 — 9月30日
 (中間配当を行う場合)

単元株式数 100株
 公告掲載URL <http://www.tclab.co.jp>
 (ただし、電子公告によることができない事故、その他のやむを得ない事由が生じたときには、日本経済新聞に掲載いたします。)

株主名簿管理人 三菱UFJ信託銀行株式会社
 特別口座の口座管理機関

同連絡先 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
 〒137-8081
 東京都江東区東砂七丁目10番11号
 TEL 0120-232-7111 (通話料無料)

上場金融商品取引所 ジャスダック証券取引所

(ご注意)

- 株券電子化に伴い、株主様の住所変更、買取請求その他各種お手続きにつきましては、原則、口座を開設されている口座管理機関(証券会社等)で承ることとなっております。口座を開設されている証券会社等にお問合せください。株主名簿管理人(三菱UFJ信託銀行)ではお取り扱いできませんのでご注意ください。
- 特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、三菱UFJ信託銀行が口座管理機関となっておりますので、上記特別口座の口座管理機関(三菱UFJ信託銀行)にお問合せください。なお、三菱UFJ信託銀行全国各支店にてもお取次ぎいたします。
- 未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行本支店でお支払いいたします。

TCL 株式会社 東京カソード研究所
 "MICRO TECHNOLOGY OF DISPLAY & SEMICONDUCTOR"
 URL <http://www.tclab.co.jp>

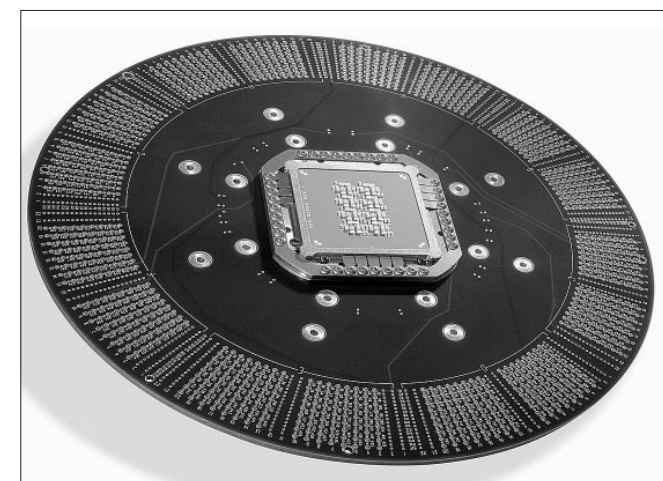


TCL 通信

SPRING 2010

2009年度 第3四半期 決算のご報告

2009.4.1—2009.12.31



Micro Spring Type

株主の皆様へ

株主の皆様におかれましては、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただきまして、厚く御礼申し上げます。2010年3月期第3四半期が終了いたしましたので、ここに「TCL通信2010年春号」をお届けいたします。

代表取締役社長

大久保 尚武

当第3四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、昨年秋以降の金融危機に端を発する世界的不況から脱出しつつあるものの、依然として個人消費や雇用情勢の回復が見込めず、景気は全体的に厳しい状況で推移しました。

電気・電子業界におきましては、パソコン市場や自動車向け需要が堅調に推移したものの、企業収益は依然先行き不透明な状況が続いています。

このように、前期からの不況の影響に加え、当社グループが2009年12月2日にリリースいたしました「事業再編計画（概要）」に基づき、中核事業と再定義しましたプローブカード事業への選択と集中の大方針に併せ、装置事業の撤退（ATE事業の売却、OVIS事業の撤退）による経営資源の集中、経営合理化の一環として希望退職者の実施、電子部品事業のモリブデン電極からの撤退など将来の収益構造および財務体質の改善のための施策を実施したため、前年同期比とは大きく売上構成が変化しつつあります。

当第3四半期は、装置事業や電子部品事業のモリブデン電極など撤退事業の影響により、当第2四半期と比べた売上高は2割以上減少しましたが（当第2四半期売上高1,614百万円から当第3四半期売上高1,249百万円へと当第2四半期比22.6%減）、一連の再編計画の推進により、売上総利益額の大幅改善（当第2四半期売上総利益96百万円から当第3四半期売上総利益239百万円へと当第2四半期比148.8%増）、および営業損失額の減少（当第2四半期営業損失511百万円から当第3四半期営業損失214百万円へと296百万円の改善）といった利益構造の抜本的改善を確認するとともに、中核事業として再定義したプローブカード事業におきましては、当第3四半期で黒字化の達成を果たすなど、全体として予定通りの進捗を確認することができました。

この結果、当第3四半期連結累計期間における当社グループ（当社、連結子会社及び持分法適用会社）の経営成績につきましては、売上高は4,903百万円（前年同期比50.7%減）、営業損失が861百万円（前年同期547百万円の営業損失）、経常損失が881百万円（前年同期625百万円の経常損失）、四半期純損失として2,338百万円（前年同期1,616百万円の四半期純損失）を計上することとなりました。

セグメント別概況



電子部品事業

売上高 1,356百万円
（前年同期比65.8%減）

営業利益 △241百万円
（前年同期236百万円の営業利益）

主力のモリブデンカップおよびモリブデン電極について、モリブデン電極が高コスト面から敬遠され、撤退を決めたことにより売上げを計画通りに上げることができませんでした。半導体部品については、半導体メーカーが部品のリサイクルを行ったことに伴い新規部品の売上は伸び悩みました。



プローブカード事業

売上高 2,192百万円
（前年同期比39.3%減）

営業利益 23百万円
（前年同期△105百万円の営業利益）

半導体市場は緩やかに回復が始まりました。当社の売上げもカンチレバー型で当第2四半期比7.4%増、垂直型で同25.4%増と確実な回復を見ることができましたが、一連の再編に伴う選択と集中の下、生産性の向上をはじめとする積極的な経営合理化施策により、営業利益ベースでは売上げの伸び率を上回る改善（それぞれ83.4%増、70.9%増）を実現することができ、プローブカード事業全体での四半期黒字復活を果たすことができました。



OVIS事業

売上高 157百万円
（前年同期比78.3%減）

営業利益 △207百万円
（前年同期△101百万円の営業利益）

ATE事業同様撤退を決めたOVIS事業の売上げは、当第3四半期において、当初初めて光学機器メーカー向けマスク検査装置を出荷することができましたが、その他の装置売上げの見通しが立たず、当第2四半期までの損失を補うことはできませんでした。

トピックス

当社は2009年12月にフォーム・ファクター社（以下「FFI社」といいます。）とプローブカード事業について業務提携を行いましたので、業務提携の内容を簡単にご紹介します。

Q1. FFI社とはどのような会社ですか？

FFI社は米国のプローブカードメーカーとして1993年ニューヨークに設立されました。

自社開発のMEMS技術によってプローブカード業界を席捲し、2003年から米国NASDAQ市場に株式を公開、2008年のプローブカード世界シェアNo.1の企業として世界の大手半導体メーカーから高い評価を得ています。

現在は研究開発と製造拠点の本拠地をカリフォルニアに移転しています。

Q2. FFI社と業務提携した理由を教えてください

半導体の製造工程において、小型化・高機能化による微細化が進んでおり、集積回路の回路幅に応じた、新たなプロービングの構築が求められています。

日本国内の半導体メーカーと長年に亘る納入実績において築き上げてきた当社のカンチレバー技術ではありますが、近年は製造工程の微細化を背景とした困難なテスト要求も存在しており、取引先の要求に幅広く対応する必要性に迫られていました。

FFI社が保有するMEMSコンタクト技術は、世界シェアNo.1の実績（2008年）を誇っており、最先端SoC（複数の機能ブロックを集積する集積回路）における取引先の要求を満たすべくあらゆる接触検査への手法を保有しています。

最先端のコンタクト技術でSoCテストソリューションを幅広く構築したい当社と日本国内の販売チャンネルを強化したいFFI社との経営戦略が合致した点が、提携の主な理由と言えるでしょう。

Q3. 業務提携の内容を簡単に紹介してください

当社は、FFI社が開発したプローブカード「TrueScale™」を日本国内のロジックおよびSoCメーカー向けに販売します。

またFFI社製品（TrueScale Lite™）のプローブカード組立と完成品の出荷検査を行う製造協業の他、基板設計や取引先での製品立ち上げおよびメンテナンスサポートまで行う予定となっており、2008年の代理店契約（パラメトリック・イメージセンサー製品）と比べより強固な提携関係となります。

なお、提携業務は2010年1月1日より活動を開始しています。

Q4. 業務提携による当社のメリットを教えてください

当社にとって日本国内の取引先に対する製品ラインナップが拡充することにより、これまでカンチレバーでは困難であったテスト要求に対しても、顧客ニーズに幅広く対応することが可能となります。

特にMEMSコンタクト技術を使用することにより、最先端SoC製造工程における狭ピッチ化への対応と、ウェハ接触テスト時の安定接触によるテスト不良低減の実現により、全体的な歩留まり向上への貢献が予想されます。

さらに内蔵メモリにおいても圧倒的な多ピン対応力により多並列テストを可能としており、テスト時間の短縮が期待できます。

当社では、カンチレバーとMEMSの相互補完によって取引先の問題解決や要求の実現をサポートすることにより日本国内でのプローブカードシェアアップに繋がりたいと考えています。